

請求の範囲

- [請求項1] 第1部材と第2部材とが左右に隣接されてなる環状の複合シール材であって、
前記第1部材が、
シール本体部と、
前記シール本体部から、前記複合シール材の厚さ方向の上方側に向かって延設されたリップ部と、
を備え、
前記第1部材のリップ部は、
隣接する前記第2部材とは逆側の外方に向かって傾斜姿勢で延出されていることを特徴とする複合シール材。
- [請求項2] 前記リップ部の傾斜角度が、30～60度の範囲内であることを特徴とする請求項1に記載の複合シール材。
- [請求項3] 前記第1部材のシール本体部には、
隣接する前記第2部材とは逆側の側部に膨出部が設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の複合シール材。
- [請求項4] 前記シール本体部の底部は、
平面で構成されていることを特徴とする請求項1～3のいずれか一項に記載の複合シール材。
- [請求項5] 前記シール本体部の底部には、
凹部が設けられていることを特徴とする請求項1～3のいずれか一項に記載の複合シール材。
- [請求項6] 前記第2部材は、
基部と、
前記基部から、前記複合シール材の厚さ方向の上方側に向かって延設された延設片と、
を備え、
前記延設片は、

隣接する前記第 1 部材に向かって傾斜姿勢で延出されていることを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載の複合シール材。

[請求項 7] 前記延設片の傾斜角度が、50 ～ 80 度の範囲内であることを特徴とする請求項 6 に記載の複合シール材。

[請求項 8] 前記基部の底部は、
平面で構成されていることを特徴とする請求項 6 または 7 に記載の複合シール材。

[請求項 9] 前記基部には、
前記第 1 部材に嵌め合わされる嵌合凸部が設けられていることを特徴とする請求項 6 ～ 8 のいずれか一項に記載の複合シール材。

[請求項 10] 前記第 1 部材が、弾性部材から成り、
前記第 2 部材が、前記第 1 部材よりも硬質の材料から成ることを特徴とする請求項 1 ～ 9 のいずれか一項に記載の複合シール材。

[請求項 11] 前記第 1 部材と第 2 部材とが、互いに接着剤で接着されていることを特徴とする請求項 1 ～ 10 のいずれか一項に記載の複合シール材。

[請求項 12] 前記複合シール材は、
一方部材と他方部材との間を封止するのに用いられ、前記一方部材に設けられたシール溝内に装着した際において、
前記シール溝の一方壁側に前記第 1 部材が位置し、他方壁側に前記第 2 部材が位置することを特徴とする請求項 1 ～ 11 のいずれか一項に記載の複合シール材。

[請求項 13] 前記複合シール材の厚さ方向の最大高さが、前記シール溝の最大深さに対して、1.10 ～ 1.70 倍の範囲内であることを特徴とする請求項 12 に記載の複合シール材。

[請求項 14] 前記複合シール材の左右方向における第 1 部材の端部から第 2 部材の端部までの最大幅が、前記シール溝の開口の最狭幅に対して、1.01 ～ 1.30 倍の範囲内であることを特徴とする請求項 12 または 13 に記載の複合シール材。

- [請求項15] 前記シール溝が、
あり溝、片あり溝、角溝のいずれかであることを特徴とする請求項
12～14のいずれか一項に記載の複合シール材。
- [請求項16] 前記一方部材と他方部材が、半導体製造装置であることを特徴とす
る請求項12～15のいずれか一項に記載の複合シール材。
- [請求項17] 前記一方部材に設けられたシール溝の外側に、さらに別の溝が設け
られており、前記別の溝内には、断面略四角形状のスペーサ部材が
配設されていることを特徴とする請求項12～16のいずれか一項に
記載の複合シール材。
- [請求項18] 前記スペーサ部材が別の溝に配設された際において、
前記別の溝の開口から前記他方部材側に突出する前記スペーサ部
材の突出量が0.30～1.00mmの範囲内であることを特徴とす
る請求項17に記載の複合シール材。